

ВИКИПЕДИЯ

Список чипсетов Intel

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

В этой статье в хронологическом порядке перечисляются чипсеты, выпущенные фирмой Intel, и указываются их характеристики. Ввиду того, что фирмой Intel выпускаются материнские платы собственного производства, имеется некоторое наложение (отличие) стандартов, применяемых для изготовления и маркировки чипсетов, выпускаемых «на сторону», и материнскими платами, которые выпускаются под брендом Intel.

Содержание

Ранние чипсеты

Для процессоров i286/i386

400 серия для процессоров 80486, P5 и P6

800 и 900 серии для процессоров P6, NetBurst и Core 2

Для настольных компьютеров

3 и 4 серии для процессоров Core 2

5 серия для процессоров Nehalem и Westmere

6 и 7 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge

8 и 9 серии для процессоров Haswell и Broadwell

100 и 200 серии для процессоров Skylake, Kaby Lake и Cascade Lake

300 серия для процессоров Coffee Lake (Refresh)

400 серия для процессоров Comet Lake

500 серия для процессоров Rocket Lake

Для мобильных компьютеров

4 серия для процессоров Core 2

5 серия для процессоров Nehalem и Westmere

6 и 7 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge

8 и 9 серии для процессоров Haswell и Broadwell
100 и 200 серии для процессоров Skylake и Kaby Lake (Refresh)
300 серия для процессоров Coffee Lake (Refresh) и Cannon Lake
400 серия для процессоров Comet Lake

Для серверов и рабочих станций

3000, 5000 и 7300 серии для процессоров Core 2
3400, 5500 и 7500 серии для процессоров Nehalem и Westmere
C200 и C600 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge
C220 и C610 серии для процессоров Haswell и Broadwell
C230, C420 и C620 серии для процессоров Skylake, Kaby Lake и Cascade Lake
C240 серия для процессоров Coffee Lake
400 и C620A серии для процессоров Comet Lake и Cooper Lake

Другие чипсеты

Документация

См. также

Примечания

Ранние чипсеты

Для процессоров i286/i386

Для своих микропроцессоров Intel 80286 и Intel 80386SX Intel лицензировала чипсеты POACH фирмы ZyMOS.

В списке ранних чипсетов Intel:

- 82350 EISA
- 82350DT EISA
- 82310 MCA
- 82340SX PC AT
- 82340DX PC AT
- 82320 MCA

- Следующие развитие чипсетов ознаменовалось внедрением «*хабовой архитектуры*» с использованием концепции северного и южного мостов. Эта серия под 800-ми номерами получила развитие в 1999 году.

400 серия для процессоров 80486, P5 и P6

Следующие поколения чипсетов можно условно объединить в 400-ю серию, по внутреннему и коммерческому именованию чипсетов серии.

800 и 900 серии для процессоров P6, NetBurst и Core 2

82360SL — чипсет для мобильных процессоров 80386SL и 80486SL. Включал в себя контроллеры DMA, PIC, COM- и LPT-порты и логику управления энергопотреблением.

Для настольных компьютеров

3 и 4 серии для процессоров Core 2

Чипсет (северный мост)	Дата выхода	Шина		Южный мост (ICH)	Поддержка ОЗУ		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия		Тип	Объём		
P31 (http://ark.intel.com/ru/products/33041)	2007/7	FSB (800/1066 МГц)		ICH7	DDR2 667/800	до 4 ГБ	Нет	15,5 Вт
G31 (http://ark.intel.com/ru/products/31913)							Intel® GMA 3100	17 Вт
G33 (http://ark.intel.com/ru/products/31914)	2007/6	FSB (800/1066/1333 МГц)	1 PCI Express x16 1.1	ICH9, ICH9-R, ICH9-DH	DDR2 667/800 DDR3 800/1066	до 8 ГБ	Intel® GMA X3100	19 Вт
Q33 (http://ark.intel.com/ru/products/31917)	2007/8			ICH9, ICH9-R, ICH9-DO	DDR2 667/800			15 Вт
P35 (http://ark.intel.com/ru/products/31916)	2007/6			ICH9, ICH9-R, ICH9-DH	DDR2 667/800 DDR3 800/1066	Нет	18 Вт	
G35 (http://ark.intel.com/ru/products/31915)					DDR2 667/800	Intel® GMA X3500	28 Вт	
Q35 (http://ark.intel.com/ru/products/31918)	2007/8	ICH9, ICH9-R, ICH9-DO			15 Вт			

X38 (http://ark.intel.com/ru/products/31919)	2007/10	FSB (800/1066/1333 МГц)	2 PCI Express x16 2.0	ICH9, ICH9-R, ICH9-DH	DDR2 667/800 DDR3 800/1066	до 16 ГБ	Нет	26,5 Вт							
G41 (http://ark.intel.com/ru/products/36528)	2008/9		1 PCI Express x16 1.1	ICH7, ICH7-R			Intel® GMA 4500	25 Вт							
P43 (http://ark.intel.com/ru/products/36525)	2008/6		1 PCI Express x16 2.0	ICH10-D			ICH10, ICH10-R	Нет	22 Вт						
G43 (http://ark.intel.com/ru/products/36524)								Intel® GMA X4500	24 Вт						
B43	2009/5							ICH10-R	ICH10, ICH10-R	Intel® GMA X4500	17 Вт				
Q43 (http://ark.intel.com/ru/products/36526)	2008/9									Нет	22 Вт				
P45 (http://ark.intel.com/ru/products/35133)	2008/6									ICH10-DO	ICH10, ICH10-R	Intel® GMA X4500HD	24 Вт		
G45 (http://ark.intel.com/ru/products/35132)												Intel® GMA X4500	17 Вт		
Q45 (http://ark.intel.com/ru/products/36527)	2008/9											2 PCI Express x16 2.0	ICH9, ICH9-R	DDR2 667/800 DDR3 800/1066/1333	до 8 ГБ
X48 (http://ark.intel.com/ru/products/35143)	2008/3	FSB (800/1066/1333/1600 МГц)													

5 серия для процессоров Nehalem и Westmere

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB	Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	Интерфейсы	RAID		
Nehalem / Westmere								
B55	2010/6	DMI (2 ГБ/с)	6 <u>PCI Express</u> x1 2.0 4 <u>PCI</u> 2.3	12	6 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с)	Нет	Intel® FDI ¹ , Intel® GbE, Intel® HDA, Intel® AC'97	4,7 Вт
H55 (http://ark.intel.com/ru/products/42703)	2009/9							8 <u>PCI Express</u> x1 2.0 4 <u>PCI</u> 2.3
P55 (http://ark.intel.com/ru/products/42690)								
H57 (http://ark.intel.com/ru/products/42700)								
Q57 (http://ark.intel.com/ru/products/42706)								

Чипсет (северный мост)	Дата выхода	Шина		Южный мост (ICH)	Поддержка ОЗУ		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия		Тип	Объём		
Nehalem-E / Westmere-E								
X58 (http://ark.intel.com/ru/products/36785)	2008/11	<u>QPI</u> (25,6 ГБ/с)	2 <u>PCI Express</u> x16 2.0 1 <u>PCI Express</u> x4 2.0	ICH10, ICH10-R	Нет	Нет	Нет	24,1 Вт

- Во время разработки процессоров нового поколения согласно стратегии Тик-так, их микроархитектура претерпела кардинальные изменения и получила новый набор логики: контроллер памяти, встроенное видеоядро и контроллер интерфейса PCI-Express x16. В связи с этим производитель Intel решил отказаться от «северного» чипсета MCH/GMCH (Graphics and Memory Controller Hub), а чипсеты, начиная с 5 серии, стали представлять собой некоторую модификацию «южного» и вместо традиционной аббревиатуры

ICH (I/O Controller Hub) получили название PCH (Platform Controller Hub). Чипсет топовой категории X58 получил только контроллер интерфейса PCI-Express x16 и стал промежуточным IOH мостом.

- ¹ Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP. Не поддерживается чипсетом P55.

6 и 7 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP	
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID			
Sandy Bridge / Ivy Bridge										
H61 (http://ark.intel.com/ru/products/52806)	2011/2	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	6 PCI Express x1 2.0	10	Нет	4 SATA 2.0 (3 Гбит/с)	Нет	Intel® FDI ² , Intel® GbE, Intel® HDA	6,1 Вт	
B65 (http://ark.intel.com/ru/products/52801)				12		5 SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1 SATA 3.0 (6 Гбит/с)				
Q65 (http://ark.intel.com/ru/products/52811)	2011/4		14				4 SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2 SATA 3.0 (6 Гбит/с)			Да
P67 (http://ark.intel.com/ru/products/52810)	2011/1									
H67 (http://ark.intel.com/ru/products/52807)										
Q67 (http://ark.intel.com/ru/products/52812)	2011/2									
Z68 (http://ark.intel.com/ru/products/52816)	2011/5									

B75 (http://ark.intel.com/ru/products/64030)	2012/4			12						
Q75 (http://ark.intel.com/ru/products/64033)	2012/6					5 SATA 2.0 (3 Гбит/с) 1 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Нет			
Z75 (http://ark.intel.com/ru/products/64021)	2012/4			14	4	4 SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Да			6,7 Вт
H77 (http://ark.intel.com/ru/products/64018)										
Q77 (http://ark.intel.com/ru/products/64027)	2012/6									
Z77 (http://ark.intel.com/ru/products/64024)	2012/4									
Sandy Bridge-E / Ivy Bridge-E										
X79 (http://ark.intel.com/ru/products/64015)	2011/4	<u>DMI 2.0</u> (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	14	Нет	4 SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>		7,8 Вт

¹ Поддержка PCI только для следующих чипсетов: B65, Q65, Q67, B75, Q75, Q77.

² Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP. Не поддерживается чипсетом P67.

8 и 9 серии для процессоров Haswell и Broadwell

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Haswell / Broadwell									
H81 (http://ark.intel.com/products/75016)	2013/6	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	6 PCI Express x1 2.0	10	2	2 SATA 2.0 (3 Гбит/с) 2 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	Intel® FDI, Intel® GbE, Intel® HDA	4,1 Вт
B85 (http://ark.intel.com/products/75019)			12	4	2 SATA 2.0 (3 Гбит/с) 4 SATA 3.0 (6 Гбит/с)				
Q85 (http://ark.intel.com/products/75010)			14						
H87 (http://ark.intel.com/products/75004)									
Q87 (http://ark.intel.com/products/75007)				6	6 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Да			
Z87 (http://ark.intel.com/products/75013)									
H97 (http://ark.intel.com/products/82010)	2014/5	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	8 PCI Express x1 2.0	14	6	6 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® GbE, Intel® HDA	6,5 Вт
Z97 (http://ark.intel.com/products/82012)									
Haswell-E / Broadwell-E									
X99 (http://ark.intel.com/products/81761)	2014/8	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	8 PCI Express x1 2.0	14	6	10 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® GbE, Intel® HDA	6,5 Вт

- Также начиная с 8 серии чипсетов, вывод полностью отрисованной картинки на устройство отображения (дисплей) теперь проводится напрямую от процессора, за исключением интерфейса VGA. Полное прекращение поддержки шины FDI началось с чипсетов 100 серии, и, соответственно, больше не поддерживается интерфейс VGA как устаревший.
- С 8 серии чипсетов производитель Intel решил лишиться поддержки шину PCI (не путать с PCI Express) как устаревшую, что вынудило производителей системных плат (в том числе и саму компанию Intel) использовать дополнительные мосты PCI-PCI Express, поскольку спрос на «устаревший» стандарт все еще есть.

100 и 200 серии для процессоров Skylake, Kaby Lake и Cascade Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Skylake-S / Kaby Lake-S									
H110 (http://ark.intel.com/ru/products/90590)	2015/10	<u>DMI 2.0</u> (4 ГБ/с)	6 <u>PCI Express</u> x1 2.0	10	4	4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	6 Вт
B150 (http://ark.intel.com/ru/products/90592)		<u>DMI 3.0</u> (8 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 3.0	12	6	6 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			

Q150 (http://ark.intel.com/ru/products/90588)			10 <u>PCI Express</u> x1 3.0		8				
H170 (http://ark.intel.com/ru/products/90595)			16 <u>PCI Express</u> x1 3.0						
Q170 (http://ark.intel.com/ru/products/90587)			20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10		Да		
Z170 (http://ark.intel.com/ru/products/90591)	2015/8								
B250 (https://ark.intel.com/ru/products/98086)			12 <u>PCI Express</u> x1 3.0	12	6		Нет		
Q250 (https://ark.intel.com/ru/products/98084)			14 <u>PCI Express</u> x1 3.0		8				
H270 (https://ark.intel.com/ru/products/98090)	2017/1		20 <u>PCI Express</u> x1 3.0						
Q270 (https://ark.intel.com/ru/products/98088)			24 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10		Да		
Z270 (https://ark.intel.com/ru/products/98089)									
Skylake-X / Kaby Lake-X / Cascade Lake-X									
X299 (https://ark.intel.com/)	2017/5	<u>DMI 3.0</u> (8 ГБ/с)	24 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	6 Вт

[ru/products/122941](https://ark.intel.com/ru/products/122941)

300 серия для процессоров Coffee Lake (Refresh)

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB			Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	3.1	Интерфейсы	RAID		
Coffee Lake-S										
H310(C) (https://ark.intel.com/ru/products/133348)¹	2018/4	<u>DMI 2.0</u> (4 ГБ/с)	6 <u>PCI Express</u> x1 2.0	10	4	Нет	4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	Intel® Wireless-AC ² , Intel® GbE, Intel® HDA	6 Вт
B360 (https://ark.intel.com/ru/products/133332)		12 <u>PCI Express</u> x1 3.0	12	6	4	6 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да			
B365 (https://ark.intel.com/ru/products/189763)		20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	8				6		
H370 (https://ark.intel.com/ru/products/133284)		<u>DMI 3.0</u> (8 ГБ/с)		10	Нет					
Q370 (https://ark.intel.com/ru/products/133282)		2017/9	24 <u>PCI Express</u> x1 3.0	10	Нет					
Z370 (https://ark.intel.com/ru/products/125903)										
Z390 (https://ark.intel.com/ru/products/133293)	2018/12				6					

- ¹ Нехватка производственных мощностей кристаллов на базе 14-нм техпроцесса, которая привела к дефициту процессоров ^{[1][2]}, вынудила производителя Intel перевести производство чипсетов H310 на 22-нм техпроцесс, что привело к их выпуску со суффиксом "C".
- ² Чипсеты 300 серии (кроме Z370) получили несколько новшеств, одна из которых поддержка беспроводного модуля Intel Wireless-AC (при условии наличия внешнего RF-приёмника, который подключается к сетевому контроллеру в чипсете по специальной шине CNVi).

400 серия для процессоров Comet Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB			Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	3.1	Интерфейсы	RAID		
Comet Lake-S										
H410 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/201842/intel-h410-chipset.html)	2020/4	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	6 <u>PCI Express</u> x1 3.0	10	4	Нет	4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	Intel® Wireless-AX, Intel® GbE, Intel® HDA	6 Вт
B460 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/201841/intel-b460-chipset.html)			16 <u>PCI Express</u> x1 3.0	12	8		6 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да		
H470 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/201835/intel-h470-chipset.html)			20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	4				
Q470 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/201836/intel-q470-chipset.html)			24 <u>PCI Express</u> x1 3.0			6				
Z490 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/201834/intel-z490-chipset.html)										

500 серия для процессоров Rocket Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB			Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	3.1	Интерфейсы	RAID		
Rocket Lake-S										
H510	2021/1	<u>DMI 3.0</u> (8 ГБ/с)	6 <u>PCI Express</u> x1 3.0	10	4	Нет	4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	<u>Intel® Wireless-AX</u> , <u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	6 Вт
B560			12 <u>PCI Express</u> x1 3.0	12	8		6 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да		
H570			20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	4				
Z590			24 <u>PCI Express</u> x1 3.0			6				
W580						8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)				

Для мобильных компьютеров

4 серия для процессоров Core 2

Чипсет (северный мост)	Дата выхода	Шина		Южный мост (ICH)	Поддержка ОЗУ		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия		Тип	Объём		
GL40 (http://ark.intel.com/ru/products/35501)	2008/8	<u>FSB</u> (667/800 МГц)	1 <u>PCI Express</u> x16 1.0	ICH9M	<u>DDR2</u> 667/800 <u>DDR3</u> 667/800	до 4 ГБ	<u>Intel® GMA 4500MHD</u>	12 Вт
GS40 (http://ark.intel.com/ru/products/41794)	2009/6	<u>FSB</u> (800 МГц)		ICH9M-SFF				
PM45 (http://ark.intel.com/ru/products/35135)	2008/6	<u>FSB</u> (667/800/1066 МГц)		ICH9M, ICH9M-E	<u>DDR2</u> 667/800 <u>DDR3</u> 667/800/1066	до 8 ГБ	Нет	7 Вт
GM45 (http://ark.intel.com/ru/products/35134)							<u>Intel® GMA 4500MHD</u>	12 Вт
GS45 (http://ark.intel.com/ru/products/35505)	2008/8	<u>FSB</u> (800/1066 МГц)		ICH9M-SFF				

5 серия для процессоров Nehalem и Westmere

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB	Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	Интерфейсы	RAID		
Nehalem / Westmere								
HM55 (https://ark.intel.com/ru/products/43183)	2009/9	DMI (2 ГБ/с)	6 <u>PCI Express</u> x1 2.0	12	4 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с)	Нет	Intel® FDI ¹ , Intel® GbE, Intel® HDA, Intel® AC'97	3,5 Вт
PM55 (https://ark.intel.com/ru/products/42694)			8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	14	6 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с)	Да		
HM57 (https://ark.intel.com/ru/products/43179)								
QM57 (https://ark.intel.com/ru/products/43187)								
QS57 (https://ark.intel.com/ru/products/47580)								

- Как и чипсеты для настольных компьютеров, также мобильные версии переняли на себя функции «южного» и стали PCN мостом. По заявлению производителя Intel, сокращение двух чипсетов до одного позволило значительно упростить разводку материнской платы и снизить общее энергопотребление, что очень важно для мобильных компьютеров и ноутбуков для повышения их автономности.

- 1 Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP, LVDS. Не поддерживается чипсетом PM55.

6 и 7 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Sandy Bridge-M									
HM65 (https://ark.intel.com/ru/products/52808)	2011/1	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	12	Нет	4 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 2 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	<u>Intel® FDI</u> ¹ , <u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	3,5 Вт
HM67 (https://ark.intel.com/ru/products/52809)									
QM67 (https://ark.intel.com/ru/products/52813)	2011/2			14			Да		
QS67 (https://ark.intel.com/ru/products/52814)									
UM67 (https://ark.intel.com/ru/products/52815)				Нет					
Ivy Bridge-M/U/Y									

HM70 (https://ark.intel.com/ru/products/67419)	2012/4	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	4 <u>PCI Express</u> x1 2.0	8	2	3 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 1 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	Intel® FDI ¹ , Intel® GbE, Intel® HDA	4,1 Вт
HM75 (https://ark.intel.com/ru/products/64348)			8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	12	Нет	4 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 2 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			
HM76 (https://ark.intel.com/ru/products/64345)									
HM77 (https://ark.intel.com/ru/products/64339)	2012/6	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	14	4	4 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 2 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® FDI ¹ , Intel® GbE, Intel® HDA	3,6 Вт
QM77 (https://ark.intel.com/ru/products/64333)									
QS77 (https://ark.intel.com/ru/products/64336)									
UM77 (https://ark.intel.com/ru/products/64342)	2012/4	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	4 <u>PCI Express</u> x1 2.0	10		3 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 1 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			3 Вт

- ¹ Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort, eDP, LVDS. Чипсетом UM77 не поддерживается VGA и LVDS.

8 и 9 серии для процессоров Haswell и Broadwell

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Haswell-H/M/U ¹ /Y ¹ и Broadwell-H/M/U ¹ /Y ¹									
HM86 (https://ark.intel.com/ru/products/75531)	2013/6	<u>DMI 2.0</u> (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	14	2	2 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Нет	<u>Intel® FDI</u> ² , <u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	2,7 Вт
HM87 (https://ark.intel.com/ru/products/75528)					4				
QM87 (https://ark.intel.com/ru/products/75525)					4				
HM97	2014/5								

- ¹ Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.

- ² Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: VGA.

100 и 200 серии для процессоров Skylake и Kaby Lake (Refresh)

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Skylake-H/U ¹ /Y ¹									
HM170 (https://ark.intel.com/ru/products/90584)	2015/10	<u>DMI 3.0</u> (8 ГБ/с)	16 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	8	4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	2,6 Вт
QM170 (https://ark.intel.com/ru/products/90583)									
CM236 (https://ark.intel.com/ru/products/90593)			20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	10	8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	3,7 Вт			
Kaby Lake-H/U ¹ /Y ¹									
HM175 (https://ark.intel.com/ru/products/98085)	2017/1	<u>DMI 3.0</u> (8 ГБ/с)	16 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	8	4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	2,6 Вт
QM175 (https://ark.intel.com/ru/products/98083)									
CM238 (https://ark.intel.com/ru/products/98087)			20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	10	8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	3,7 Вт			

- ¹ Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.

300 серия для процессоров Coffee Lake (Refresh) и Cannon Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB			Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	3.1	Интерфейсы	RAID		
Coffee Lake-H/U ¹ / Cannon Lake-U ¹										
HM370 (https://ark.intel.com/ru/products/135101)	2018/4	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	16 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	6	4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® Wireless-AC, Intel® GbE, Intel® HDA	3 Вт
QM370 (https://ark.intel.com/ru/products/135102)			20 <u>PCI Express</u> x1 3.0							
CM246 (https://ark.intel.com/ru/products/135100)			24 <u>PCI Express</u> x1 3.0							

- ¹ Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.

400 серия для процессоров Comet Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB			Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP		
		Системная	Периферия	2.0	3.0	3.1	Интерфейсы	RAID				
Comet Lake-H/U ¹												
HM470 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/203697/intel-hm470-chipset.html)	2020/4	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	16 PCI Express x1 3.0	14	8	4	4 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® Wireless-AX , Intel® GbE , Intel® HDA	3 Вт		
QM480 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/203698/intel-qm480-chipset.html)			20 PCI Express x1 3.0								10	6
WM490 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/204447/intel-wm490-chipset.html)			24 PCI Express x1 3.0									

- ¹ Представляют собой систему на чипе (SoC), состоящую из процессора и чипсета, интегрированных на одной подложке.

Для серверов и рабочих станций

У всех серверных чипсетов отсутствует встроенное видеоядро по причине ненужности. Для вывода изображения на монитор иногда пользуются дискретными видеокартами или непосредственно встроенными на материнской плате (процессоре).

Значения индексов процессоров:

- UP/EN/W — однопроцессорные конфигурации, семейство чипсетов 3xxx/C2xx/C4xx;
- DP/EP — двухпроцессорные конфигурации, семейство чипсетов 5xxx/C6xx;
- MP/EX/SP — многопроцессорные конфигурации, семейство чипсетов 7xxx/C6xx.

3000, 5000 и 7300 серии для процессоров Core 2

Чипсет (северный мост)	Дата выхода	Шина		Южный мост (ICH)	Поддержка ОЗУ		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия		Тип	Объём		
Core-UP								
3200 (http://ark.intel.com/ru/products/34387)	2007/11	FSB (800/1066/1333 МГц)	1 PCI Express x8 1.1	ICH9, ICH9-R	DDR2 677/800	до 8 ГБ	Нет	20 Вт
3210 (http://ark.intel.com/ru/products/34391)			1 PCI Express x16 1.1					21,3 Вт
Core-DP								
5100 (http://ark.intel.com/ru/products/33142)	2007/10	FSB (800/1066/1333 МГц)	3 PCI Express x8 1.0a	ICH9, ICH9-R	DDR2 533/677	до 48 ГБ	Нет	25,7 Вт
5400 (http://ark.intel.com/ru/products/34474)	2007/11	FSB (1066/1333/1600 МГц)	4 PCI Express x8 2.0	6311ESB, 6321ESB	FBD DDR2 533/677	до 128 ГБ		38 Вт
Core-MP								
7300 (http://ark.intel.com/ru/products/34347)	2007/11	FSB (800/1066 МГц)	3 PCI Express x8 1.0a 1 PCI Express x4 1.0a	6311ESB, 6321ESB	FBD DDR2 533/677	до 256 ГБ	Нет	47 Вт

3400, 5500 и 7500 серии для процессоров Nehalem и Westmere

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB	Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	Интерфейсы	RAID		
Nehalem-EN / Westmere-EN								
3400 (http://ark.intel.com/ru/products/42907)	2009/9	DMI (2 ГБ/с)	6 PCI Express x1 2.0 4 PCI 2.3	8	4 SATA 2.0 (3 Гбит/с)	Нет	Intel® GbE	5,9 Вт
3420 (http://ark.intel.com/ru/products/42904)			8 PCI Express x1 2.0 4 PCI 2.3	12	6 SATA 2.0 (3 Гбит/с)	Да		
3450 (http://ark.intel.com/ru/products/47913)			14				Intel® FDI ¹ , Intel® GbE, Intel® HDA	

Чипсет (северный мост)	Дата выхода	Шина		Южный мост (ICH)	Поддержка ОЗУ		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия		Тип	Объём		
Nehalem-EP / Westmere-EP								
5500 (http://ark.intel.com/ru/products/36784)	2009/5	QPI (25,6 ГБ/с)	1 PCI Express x16 2.0 2 PCI Express x4 2.0	ICH9, ICH9-R ICH10, ICH10-R	Нет	Нет	Нет	27,1 Вт
5520 (http://ark.intel.com/ru/products/36783)			2 PCI Express x16 2.0 1 PCI Express x4 2.0					
Nehalem-EX / Westmere-EX								
7500 (http://ark.intel.com/ru/products/49286)	2010/3	QPI (25,6 ГБ/с)	2 PCI Express x8 2.0 1 PCI Express x4 2.0	ICH10, ICH10-R	Нет	Нет	Нет	27,1 Вт

- ¹ Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, SDVO, DisplayPort.

C200 и C600 серии для процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Sandy Bridge-EN / Ivy Bridge-EN									
C202 (http://ark.intel.com/ru/products/52803)	2011/4	DMI 2.0 (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 2.0 4 <u>PCI</u> 2.3	12	Нет	6 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с)		Intel® GbE	6,7 Вт
C204 (http://ark.intel.com/ru/products/52804)						4 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 2 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			
C206 (http://ark.intel.com/ru/products/52805)				14	4				
C216 (http://ark.intel.com/ru/products/66416)	2012/5							Intel® FDI ¹ , Intel® GbE, Intel® HDA	
Sandy Bridge-EP / Ivy Bridge-EP									

C602 (http://ark.intel.com/ru/products/63984)	2012/3	<u>DMI 2.0</u> (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express x1 2.0</u> 4 <u>PCI 2.3</u>	14	Нет	4 <u>SATA 2.0</u> (3 Гбит/с) 2 <u>SATA 3.0</u> (6 Гбит/с) 8 <u>SAS 2.0</u> (3 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	8 Вт
C602J (http://ark.intel.com/ru/products/6243)									12 Вт
C604 (http://ark.intel.com/ru/products/63985)									
C606 (http://ark.intel.com/ru/products/63986)									
C608 (http://ark.intel.com/ru/products/63987)									

- ¹ Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, eDP.

C220 и C610 серии для процессоров Haswell и Broadwell

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Haswell-EN									
C222 (http://ark.intel.com/products/75516)	2013/6	<u>DMI 2.0</u> (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	10	2	4 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 2 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u>	4,1 Вт
C224 (http://ark.intel.com/products/75519)				12	4	2 <u>SATA</u> 2.0 (3 Гбит/с) 4 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			
C226 (http://ark.intel.com/products/75522)				14		6 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			
Haswell-EP / Broadwell-EP									
C612 (http://ark.intel.com/products/81759)	2013/9	<u>DMI 2.0</u> (4 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 2.0	14	6	10 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	8 Вт

- ¹ Поддержка следующих интерфейсов передачи видеосигнала: VGA.

C230, C420 и C620 серии для процессоров Skylake, Kaby Lake и Cascade Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB		Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	Интерфейсы	RAID		
Skylake-S/EN / Kaby Lake-S/EN									
C232 (http://ark.intel.com/ru/products/90578)	2015/8	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	8 <u>PCI Express</u> x1 3.0	12	6	6 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® GbE	6 Вт
C236 (http://ark.intel.com/ru/products/90594)			20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	8	8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			
Skylake-W / Cascade Lake-W									
C422 (https://ark.intel.com/ru/products/126691)	2017/7	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	24 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® GbE, Intel® HDA	6 Вт
Skylake-SP / Cascade Lake-SP									

C621 (http://ark.intel.com/ru/products/97338)	2017/7	<u>DMI 3.0</u> (8 ГБ/с)	20 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	14 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	<u>Intel® GbE</u> , <u>Intel® HDA</u>	15 Вт
C622 (http://ark.intel.com/ru/products/97340)									17 Вт
C624 (http://ark.intel.com/ru/products/97341)									19 Вт
C625 (http://ark.intel.com/ru/products/97342)									21 Вт
C626 (http://ark.intel.com/ru/products/97339)									23 Вт
C627 (http://ark.intel.com/ru/products/97343)									28,6 Вт
C628 (http://ark.intel.com/ru/products/97337)									26,3 Вт
C629 (http://ark.intel.com/ru/products/149402)	2018/8								28,6 Вт

C240 серия для процессоров Coffee Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB			Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	3.1	Интерфейсы	RAID		

Coffee Lake-S/EN

C242 (http://ark.intel.com/ru/products/147324)	2018/12	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	10 <u>PCI Express</u> x1 3.0	12	6	2	6 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® Wireless-AC, Intel® GbE, Intel® HDA	6 Вт
C246 (http://ark.intel.com/ru/products/147326)			24 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	6	8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)			

400 и C620A серии для процессоров Comet Lake и Cooper Lake

Чипсет	Дата выхода	Шина		USB			Поддержка накопителей		Поддержка встроенных технологий	TDP
		Системная	Периферия	2.0	3.0	3.1	Интерфейсы	RAID		
Comet Lake-S/EN										
W480 (https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/201910/intel-w480-chipset.html)	2020/4	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	24 <u>PCI Express</u> x1 3.0	14	10	8	8 <u>SATA</u> 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® Wireless-AX, Intel® GbE, Intel® HDA	6 Вт
Cooper Lake-SP										

C621A (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/208266/intel-c621a-chipset.html)										15 Вт
C627A (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/208267/intel-c627a-chipset.html)	2020/4	DMI 3.0 (8 ГБ/с)	20 PCI Express x1 3.0	14	10	Нет	14 SATA 3.0 (6 Гбит/с)	Да	Intel® GbE, Intel® HDA	28,6 Вт
C629A (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/208268/intel-c629a-chipset.html)										

Другие чипсеты

Документация

- Intel® G31/P31 Express Chipset Datasheet (<http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/317495.pdf>)
- Intel® G35 Express Chipset Datasheet (<http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/317607.pdf>)
- Intel® 3 Series Express Chipset Family Datasheet (<http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/316966.pdf>)
- Intel® X38 Express Chipset Datasheet (<http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/317610.pdf>)
- Intel® 4 Series Express Chipset Family Datasheet (<http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/4-chipset-family-datasheet.pdf>)
- Intel® X48 Express Chipset Datasheet (<http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/319122.pdf>)
- Intel® X58 Express Chipset Datasheet (<http://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/x58-express-chipset-datasheet.pdf>)
- Intel® 5 Series Chipset and Intel® 3400 Series Chipset Datasheet (<http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/5-chipset-3400-chipset-datasheet.pdf>)

- [Intel® 6 Series Chipset and Intel® C200 Series Chipset Datasheet \(http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/6-chipset-c200-chipset-datasheet.pdf\)](http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/6-chipset-c200-chipset-datasheet.pdf)
- [Intel® 7 Series / C216 Chipset Family Platform Controller Hub \(PCH\) Datasheet \(http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/7-series-chipset-pch-datasheet.pdf\)](http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/7-series-chipset-pch-datasheet.pdf)
- [Intel® C600 Series Chipset and Intel® X79 Express Chipset Datasheet \(http://www.intel.ua/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/c600-series-chipset-datasheet.pdf\)](http://www.intel.ua/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/c600-series-chipset-datasheet.pdf)
- [Intel® 8 Series/C220 Series Chipset Family Platform Controller Hub \(PCH\) Datasheet \(http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/8-series-chipset-pch-datasheet.pdf\)](http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/8-series-chipset-pch-datasheet.pdf)
- [Intel® 9 Series Chipset Family Platform Controller Hub \(PCH\) Datasheet \(http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/9-series-chipset-pch-datasheet.pdf\)](http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/9-series-chipset-pch-datasheet.pdf)
- [Intel® C610 Series Chipset and Intel® X99 Chipset Platform Controller Hub \(PCH\) Datasheet \(http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/x99-chipset-pch-datasheet.pdf\)](http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/x99-chipset-pch-datasheet.pdf)
- [Intel® 100 Series Chipset and Intel® C230 Series Chipset Family Platform Controller Hub \(PCH\) Vol. 1 Datasheet \(https://www.mouser.com/datasheet/2/612/100-series-chipset-datasheet-vol-1-775591.pdf\)](https://www.mouser.com/datasheet/2/612/100-series-chipset-datasheet-vol-1-775591.pdf) (недоступная ссылка)
- [Intel® 100 Series Chipset and Intel® C230 Series Chipset Family Platform Controller Hub \(PCH\) Vol. 2 Datasheet \(http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/100-series-chipset-datasheet-vol-2.pdf\)](http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/100-series-chipset-datasheet-vol-2.pdf)
- [Intel® 200 Series \(including X299\) and Intel® Z370 Series Chipset Families Platform Controller Hub \(PCH\) Vol. 1 Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/200-series-chipset-pch-datasheet-vol-1.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/200-series-chipset-pch-datasheet-vol-1.pdf)
- [Intel® 200 Series \(including X299\) and Intel® Z370 Series Chipset Families Platform Controller Hub \(PCH\) Vol. 2 Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/200-series-chipset-pch-datasheet-vol-2.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/200-series-chipset-pch-datasheet-vol-2.pdf)
- [Intel® 300 Series and Intel® 240 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 1 \(https://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/300-series-chipset-pch-datasheet-vol-1.pdf\)](https://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/300-series-chipset-pch-datasheet-vol-1.pdf)
- [Intel® 300 Series and Intel® 240 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 2 \(https://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/300-series-chipset-pch-datasheet-vol-2.pdf\)](https://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/300-series-chipset-pch-datasheet-vol-2.pdf)
- [Intel® B460 and H410 Chipset Platform Controller Hub Vol. 1 Datasheet \(https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/621884\)](https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/621884)
- [Intel® B460 and H410 Chipset Platform Controller Hub Vol. 2 Datasheet \(https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/621887\)](https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/621887)
- [Intel® 400 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 1 Datasheet \(https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/620854\)](https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/620854)
- [Intel® 400 Series Chipset Family Platform Controller Hub Vol. 2 Datasheet \(https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/620855\)](https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/620855)
- [Mobile Intel® 4 Series Express Chipset Family Datasheet \(https://www.recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/82gl40-82gm45-82gs45-82p45-82pm45-320122.pdf\)](https://www.recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/82gl40-82gm45-82gs45-82p45-82pm45-320122.pdf)
- [Intel® 3200 and 3210 Chipset Memory Controller Hub \(MCH\) Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/3200-3210-chipset-memory-controller-hub-datasheet.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/3200-3210-chipset-memory-controller-hub-datasheet.pdf)
- [Intel® 5100 Chipset Memory Controller Hub \(MCH\) Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/5100-memory-controller-hub-chipset-datasheet.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/5100-memory-controller-hub-chipset-datasheet.pdf)
- [Intel® 5400 Chipset Memory Controller Hub \(MCH\) Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/5400-chipset-memory-controller-hub-datasheet.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/5400-chipset-memory-controller-hub-datasheet.pdf)
- [Intel® 7300 Chipset Memory Controller Hub \(MCH\) Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/7300-chipset-memory-controller-hub-datasheet.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/7300-chipset-memory-controller-hub-datasheet.pdf)
- [Intel® 5520 Chipset and Intel® 5500 Chipset Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/5520-5500-chipset-ioh-datasheet.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/5520-5500-chipset-ioh-datasheet.pdf)
- [Intel® 7500 Chipset Datasheet \(https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/7500-chipset-datasheet.pdf\)](https://www.intel.com/content/dam/doc/datasheet/7500-chipset-datasheet.pdf)

- **Intel® C620 Series Chipset Platform Controller Hub (PCH) Datasheet** (<https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/c620-series-chipset-datasheet.pdf>)

См. также

- [Список чипсетов AMD](#)

Примечания

1. Технологические проблемы вынудили Intel перевести чипсет H310 обратно на нормы 22 нм (<https://www.ixbt.com/news/2018/09/21/intel-h310-22.html>). Дата обращения: 23 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190106231249/https://www.ixbt.com/news/2018/09/21/intel-h310-22.html>) 6 января 2019 года.
 2. Рост цен на процессоры Intel может продолжиться из-за дефицита поставок (<https://3dnews.ru/974822>). Дата обращения: 23 сентября 2020. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20181115000958/https://3dnews.ru/974822>) 15 ноября 2018 года.
-

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Список_чипсетов_Intel&oldid=132402998

Эта страница в последний раз была отредактирована 17 августа 2023 в 06:39.

Текст доступен по лицензии Creative Commons «С указанием авторства — С сохранением условий» (CC BY-SA); в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Фонд Викимедиа (Wikimedia Foundation, Inc.)